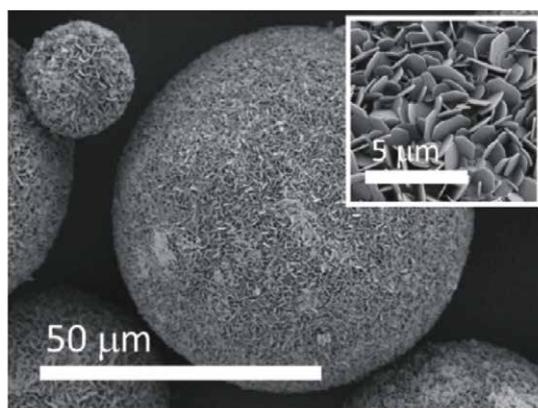
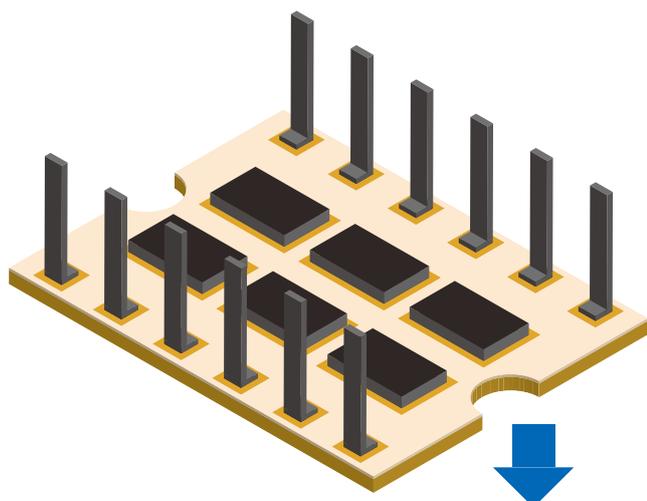


パワーモジュール対応メタルベース放熱基板

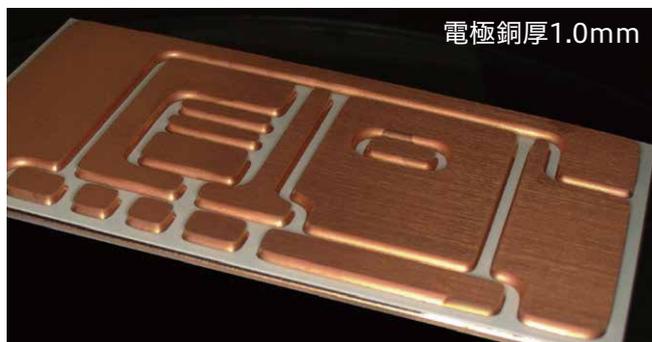
Metal base PWB for Power Module application

特長 Features

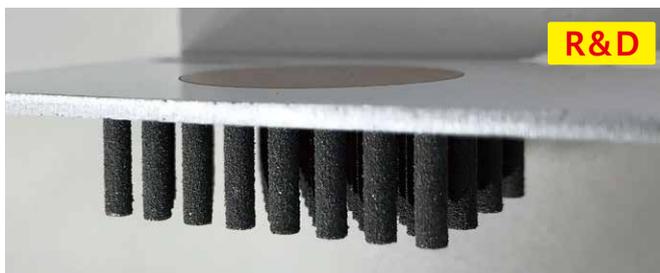
- ✓ パワーモジュール用途に最適な、低熱抵抗、高耐圧かつ扱い易い絶縁構造材料をご提案。
Good materials for Power Modules with low Rth, high Breakdown voltage, and easy handling.
- ✓ 樹脂材料の採用により低反りが可能。また厚銅化や大型化等設計自由度も向上。
Low warpage by using resin material. Also thicker Cu and larger piece size is possible.



H16ではカードハウス構造による
特殊高熱伝導BNフィラー採用



ベースプレートと電極銅の一体成型
構造簡素化による低反り、信頼性UP



ピンフィン一体構造による低熱抵抗化
銅、アルミそれぞれに対応可能

材料ラインナップ Material line-up for Power Module application

材料特性値	単位	H5	H10	H10TY	H16
熱伝導率	W/m・K	5	10	10	16
厚さ	μm	100	100	115	150
ガラス転移温度	°C	>300	>300	—	200
絶縁破壊電圧	AC kV	4	4	5	5
特長	—	高耐熱	高耐熱	低弾性	高放熱